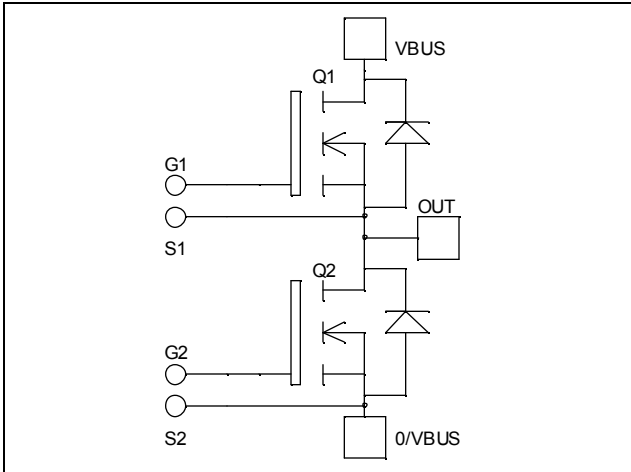


Phase leg MOSFET Power Module

$V_{DSS} = 200V$
 $R_{DSon} = 4m\Omega \text{ typ @ } T_j = 25^\circ C$
 $I_D = 372A \text{ @ } T_c = 25^\circ C$



Application

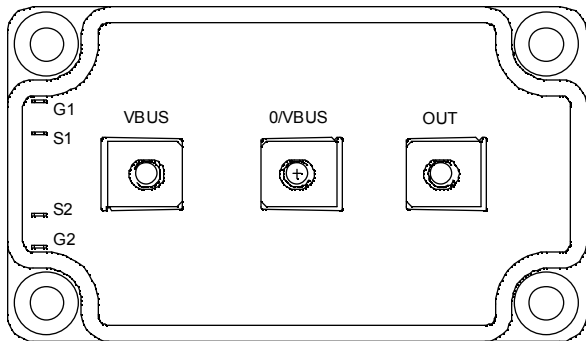
- Welding converters
- Switched Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies
- Motor control

Features

- Power MOS 7[®] FREDFETs
 - Low R_{DSon}
 - Low input and Miller capacitance
 - Low gate charge
 - Fast intrinsic reverse diode
 - Avalanche energy rated
 - Very rugged
- Kelvin source for easy drive
- Very low stray inductance
 - Symmetrical design
 - M5 power connectors
- High level of integration

Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Low profile
- RoHS Compliant



Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
V_{DSS}	Drain - Source Breakdown Voltage	200	V
I_D	Continuous Drain Current	$T_c = 25^\circ C$	372
		$T_c = 80^\circ C$	278
I_{DM}	Pulsed Drain current	1488	A
V_{GS}	Gate - Source Voltage	± 30	V
R_{DSon}	Drain - Source ON Resistance	5	$m\Omega$
P_D	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$	1250
I_{AR}	Avalanche current (repetitive and non repetitive)	100	A
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy	50	mJ
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy	3000	

CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on www.microsemi.com

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{GS} = 0\text{V}, V_{DS} = 200\text{V}$			500	μA
		$T_j = 25^\circ\text{C}$				
		$V_{GS} = 0\text{V}, V_{DS} = 160\text{V}$			2000	
$R_{DS(on)}$	Drain – Source on Resistance	$V_{GS} = 10\text{V}, I_D = 186\text{A}$		4	5	$\text{m}\Omega$
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 10\text{mA}$	3		5	V
I_{GSS}	Gate – Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 30\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$			± 200	nA

Dynamic Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0\text{V}$		28.9		nF
C_{oss}	Output Capacitance	$V_{DS} = 25\text{V}$		9.32		
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance	$f = 1\text{MHz}$		0.58		
Q_g	Total gate Charge	$V_{GS} = 10\text{V}$		560		nC
Q_{gs}	Gate – Source Charge	$V_{Bus} = 100\text{V}$		212		
Q_{gd}	Gate – Drain Charge	$I_D = 372\text{A}$		268		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive switching @ 125°C $V_{GS} = 15\text{V}$ $V_{Bus} = 133\text{V}$ $I_D = 372\text{A}$ $R_G = 1.2\Omega$		32		ns
T_r	Rise Time			64		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			88		
T_f	Fall Time			116		
E_{on}	Turn-on Switching Energy	Inductive switching @ 25°C $V_{GS} = 15\text{V}, V_{Bus} = 133\text{V}$ $I_D = 372\text{A}, R_G = 1.2\Omega$		3396		μJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy			3716		
E_{on}	Turn-on Switching Energy	Inductive switching @ 125°C $V_{GS} = 15\text{V}, V_{Bus} = 133\text{V}$ $I_D = 372\text{A}, R_G = 1.2\Omega$		3744		μJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy			3944		

Source - Drain diode ratings and characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit	
I_S	Continuous Source current (Body diode)	$T_c = 25^\circ\text{C}$			372	A	
		$T_c = 80^\circ\text{C}$			278		
V_{SD}	Diode Forward Voltage	$V_{GS} = 0\text{V}, I_S = -372\text{A}$			1.3	V	
dv/dt	Peak Diode Recovery ①				5	V/ns	
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_S = -372\text{A}$ $V_R = 133\text{V}$ $di_S/dt = 400\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$			230	ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$			450	
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge	$I_S = -372\text{A}$ $V_R = 133\text{V}$ $di_S/dt = 400\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		3.6	μC	
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		13.6		

 ① dv/dt numbers reflect the limitations of the circuit rather than the device itself.

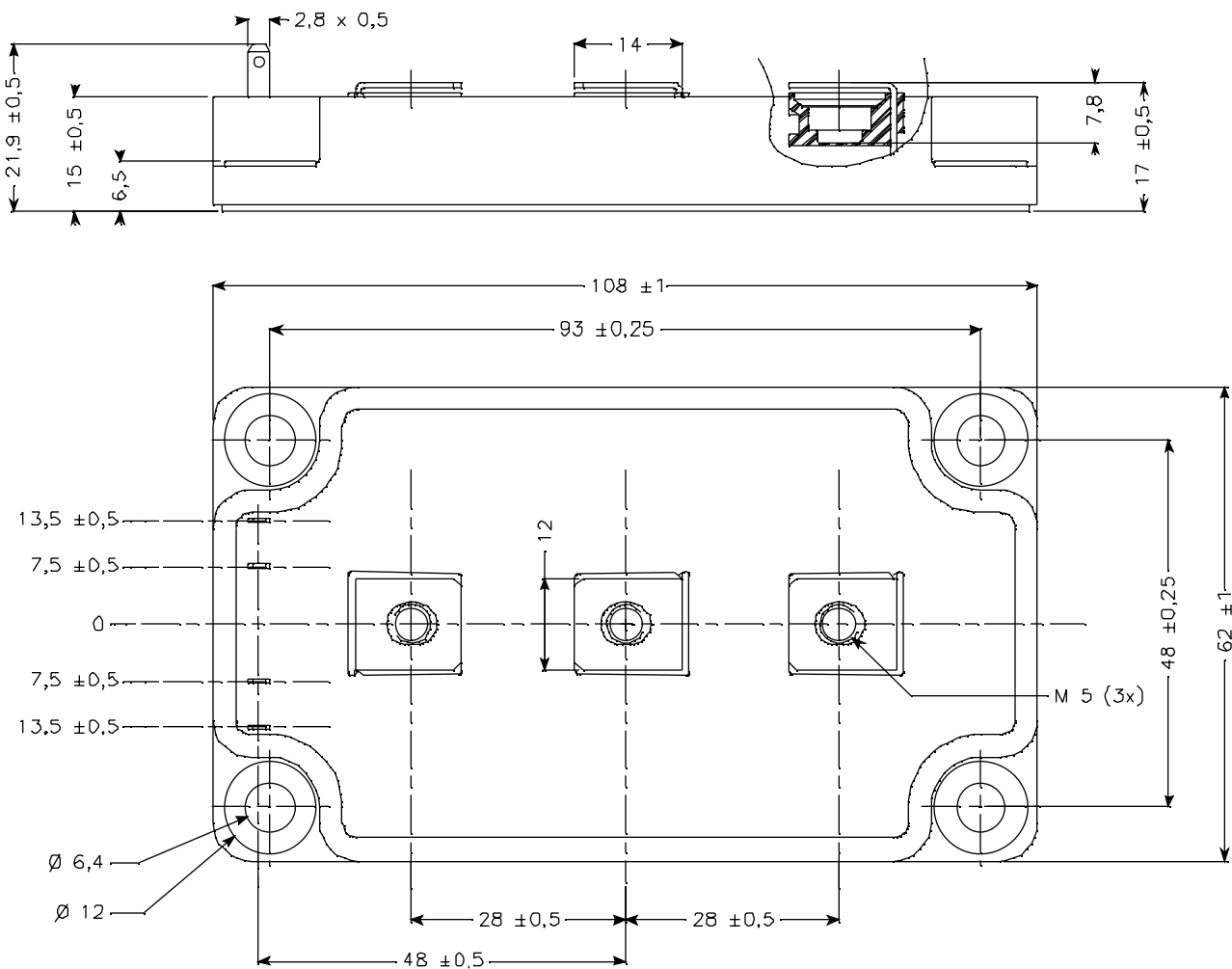
$$I_S \leq -372\text{A} \quad di/dt \leq 700\text{A}/\mu\text{s} \quad V_R \leq V_{DSS} \quad T_j \leq 150^\circ\text{C}$$

Thermal and package characteristics

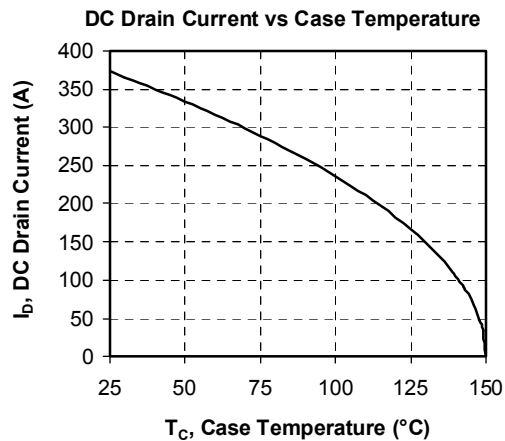
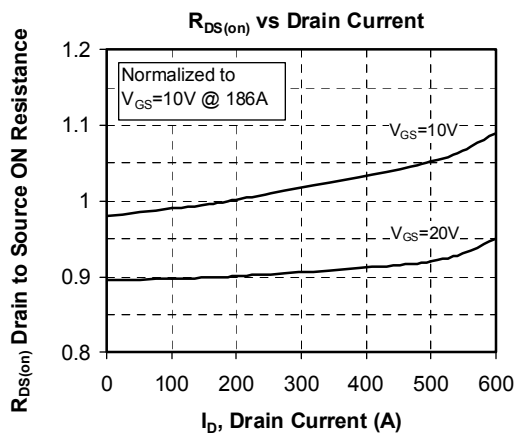
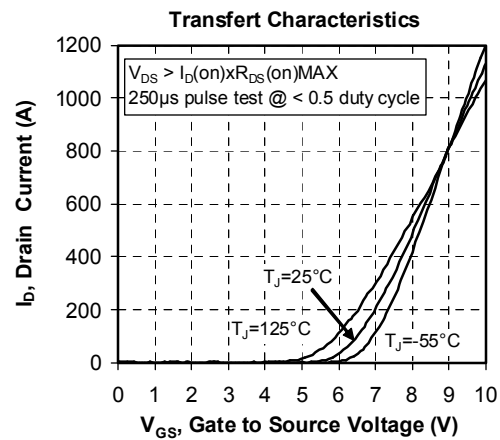
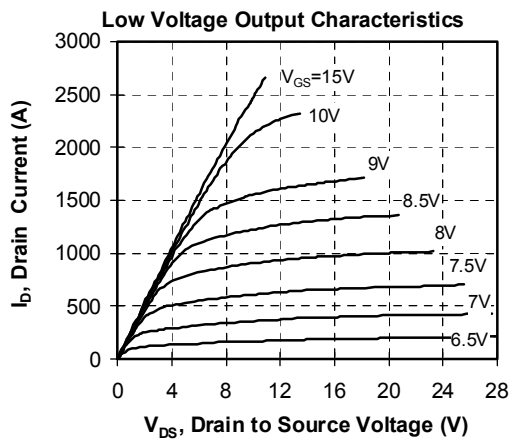
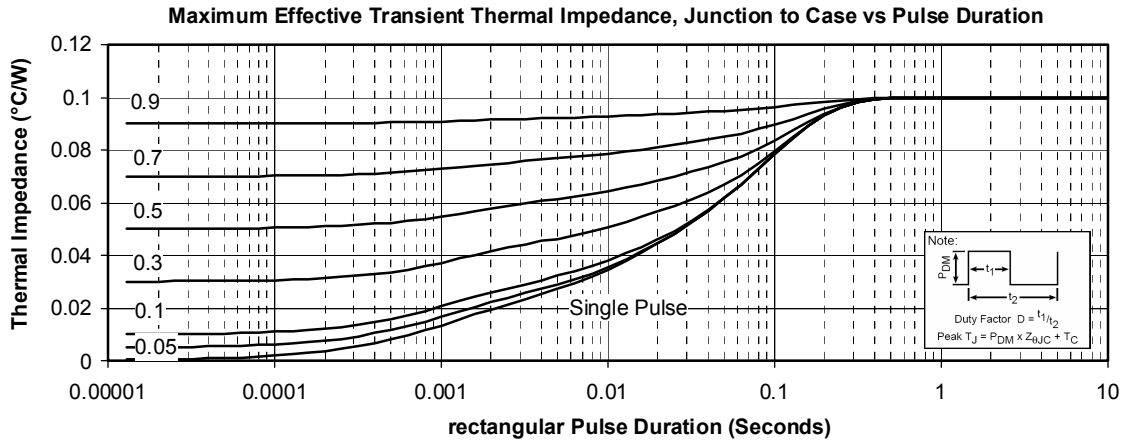
Symbol Characteristic

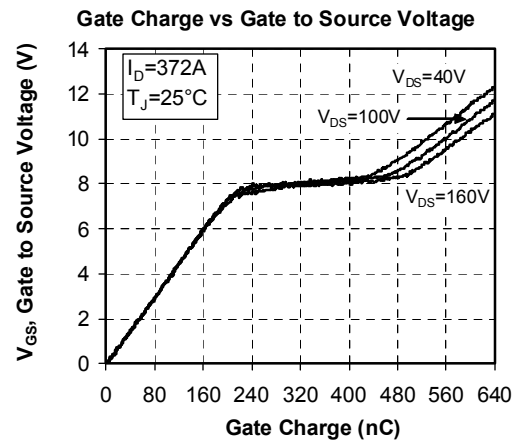
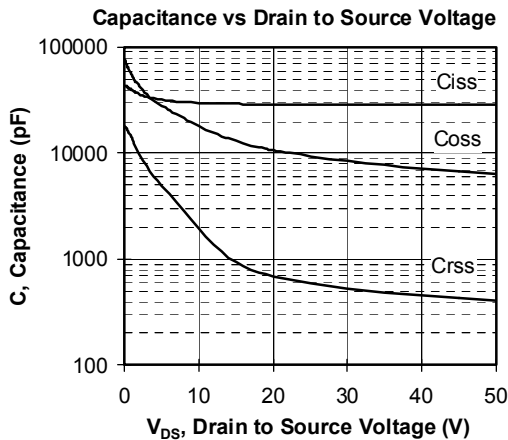
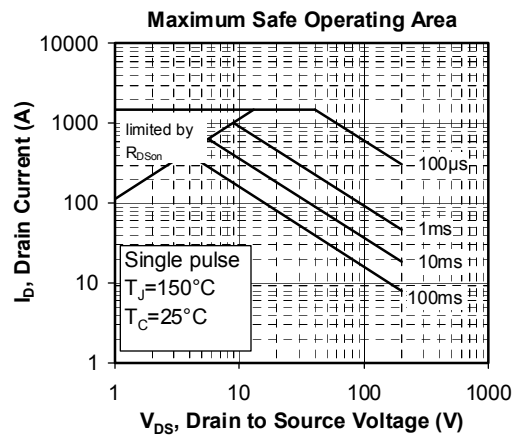
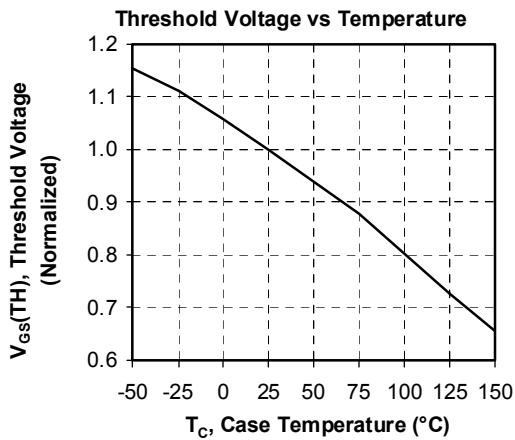
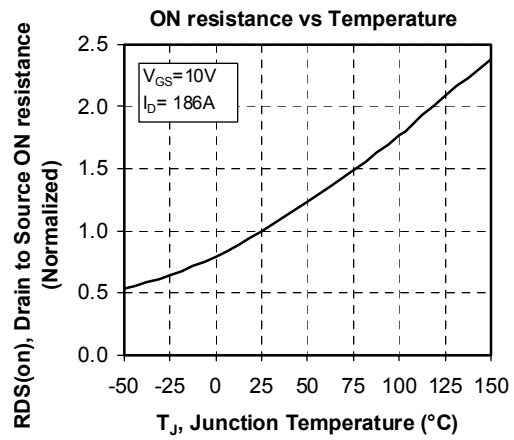
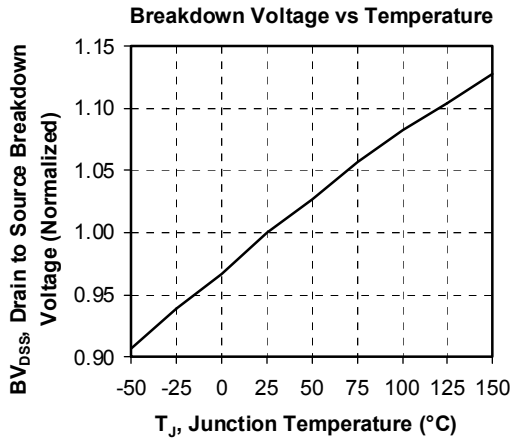
		<i>Min</i>	<i>Typ</i>	<i>Max</i>	<i>Unit</i>	
R_{thJC}	Junction to Case Thermal Resistance			0.1	°C/W	
V_{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case t=1 min, Iso<1mA, 50/60Hz	2500			V	
T_J	Operating junction temperature range	-40		150	°C	
T_{STG}	Storage Temperature Range	-40		125		
T_C	Operating Case Temperature	-40		100		
Torque	Mounting torque	To heatsink	M6	3	5	N.m
		For terminals	M5	2	3.5	
Wt	Package Weight			280	g	

SP6 Package outline (dimensions in mm)

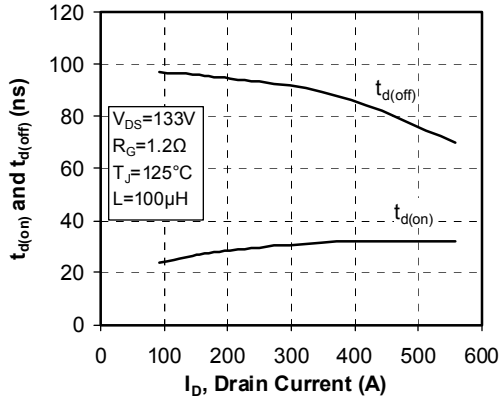


See application note APT0601 - Mounting Instructions for SP6 Power Modules on www.microsemi.com

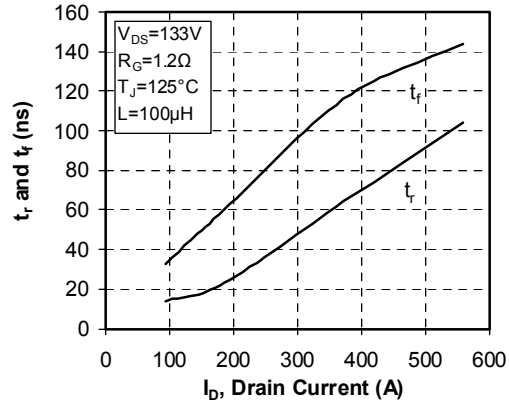
Typical Performance Curve




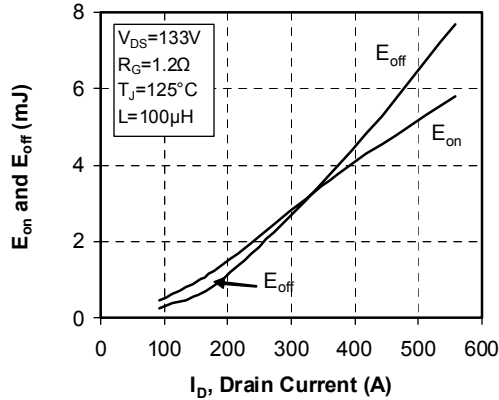
Delay Times vs Current



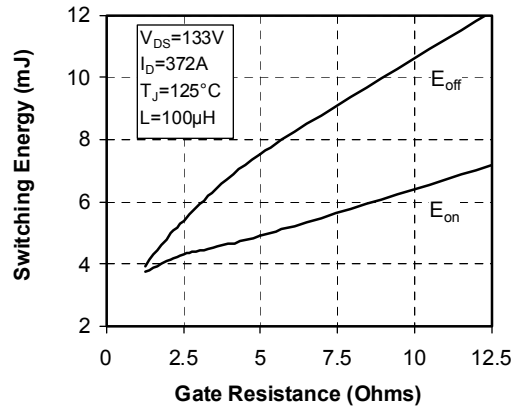
Rise and Fall times vs Current



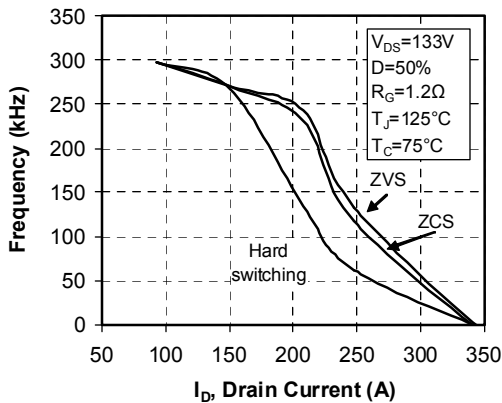
Switching Energy vs Current



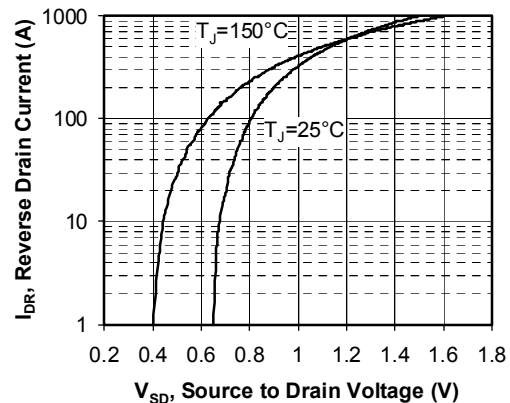
Switching Energy vs Gate Resistance



Operating Frequency vs Drain Current



Source to Drain Diode Forward Voltage



Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru